# Модель термического окисления кремния на фронте объемной реакции

# © О.В. Александров<sup>¶</sup>, А.И. Дусь

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", 197376 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 14 января 2008 г. Принята к печати 5 февраля 2008 г.)

Разработана модель термического окисления кремния, в которой взаимодействие с окислителем происходит на фронте объемной реакции. Ширина реакционной зоны соответствует ширине переходного слоя с нарушенной стехиометрией ( $\delta \approx 7.5$  Å). Учитывается релаксация коэффициента диффузии окислителя от значения в напряженном диоксиде кремния до значения в ненапряженном диоксиде кремния, равного коэффициенту диффузии в плавленом кварце. Релаксация связывается со структурной перестройкой аморфного диоксида кремния при удалении от границы реакционной зоны. Модель хорошо описывает кинетику термического окисления кремния в сухом кислороде в широком диапазоне толщин диоксида кремния, включая начальный этап.

PACS: 81.65.Mq, 82.20.Nk, 82.33.Pt

# 1. Введение

Термический диоксид кремния остается основным диэлектриком в современных кремниевых сверхбольших и ультрабольших интегральных схемах (СБИС и УБИС). С увеличением степени интеграции толщина используемых в технологии СБИС и УБИС пленок диоксида кремния уменьшается до единиц нанометров [1], поэтому разработка адекватной физической модели термического окисления кремния является важной научно-технической задачей.

В классической модели термического окисления кремния Дила–Гроува [2] полагается, что при окислении кремния в среде сухого кислорода окислителем является молекулярный кислород  $O_2$ , который диффундирует с поверхности диоксида кремния к внутренней границе раздела SiO<sub>2</sub>—Si, где вступает в реакцию с кремнием. Скорость окисления при малых временах лимитируется скоростью химической реакции (линейный закон окисления), а при больших временах — скоростью диффузии окислителя в диоксиде (параболический закон окисления). Уравнение для скорости окисления в модели Дила–Гроува [2] имеет вид

$$v_{\rm ox} = \frac{dx_{\rm ox}}{dt} = \frac{k_p}{k_p/k_l + 2x_{\rm ox}},\tag{1}$$

где  $x_{ox}$  — толщина диоксида кремния, t — время окисления,  $k_l$  и  $k_p$  — константы линейного и параболического окисления соответственно:  $k_l = kC_s/C_0$ ,  $k_p = 2DC_s/C_0$ , k — константа скорости химической реакции окисления,  $C_s$  — концентрация окислителя на поверхности оксида, D — коэффициент диффузии окислителя в диоксиде,  $C_0$  — концентрация окислителя в диоксиде ( $C_0 = 2.2 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$ ). Из сопоставления с экспериментом были найдены температурные зависимости k<sub>l</sub> и k<sub>p</sub> [3]:

$$k_l = 0.103 \exp(-2.0/k_{\rm B}T) \, {
m cm/c},$$
  
 $k_p = 2.14 \cdot 10^{-9} \exp(-1.23/k_{\rm B}T) \, {
m cm}^2/{
m c}$ 

где T — температура,  $k_{\rm B} = 8.62 \cdot 10^{-5}$  эВ/град — постоянная Больцмана. Модель Дила–Гроува [2,3] позволяет адекватно описать кинетику роста пленки диоксида кремния в сухом кислороде при толщинах свыше 30–40 нм. При меньших толщинах экспериментальная скорость окисления выше, чем рассчитанная по модели Дила–Гроува.

Для описания ускоренного роста диоксида кремния на начальном этапе термического окисления в сухом кислороде был предложен целый ряд моделей, представляющих собой различные модификации линейнопараболической модели Дила-Гроува (см. обзоры [4,5], монографии [6,7]). Так, в работах Массоуда с соавт. [8,9] в правую часть уравнения (1) были добавлены эмпирические члены, спадающие экспоненциально с толщиной оксида [8] или со временем [9]. В работах Хана и Хелмса [10], а также Вонга и Чена [11] были предложены двухпоточные модели окисления. В качестве второго окислителя помимо нейтрального молекулярного кислорода О2 предлагались кислородные вакансии в структуре диоксида, атомарный кислород [10] или заряженный молекулярный кислород О<sub>2</sub><sup>-</sup> [11]. В работах [12–15] привлекались дополнительные механизмы ускорения окисления на начальном этапе, такие как перенос окислителя по микропорам и микроканалам [12], образование пространственного заряда и внутреннего электрического поля в оксиде [13], туннелирование электронов из кремния на поверхность диоксида [14], генерация точечных дефектов на границе оксида с кремнием [15]. Фарже, Гибаудо и Камаринос [16] из анализа обратной скорости окисления показали, что аномальная скорость окисления на начальном участке связана не с ускорением химической реакции окисления или диффузии окислителя, как

<sup>¶</sup> E-mail: Aleksandrov@svs.ru

полагалось ранее, а наоборот, с замедлением диффузии окислителя в тонком слое диоксида кремния вблизи МФГ SiO<sub>2</sub>—Si. Замедление диффузии связывалось с внутренними механическими напряжениями сжатия в диоксиде кремния, обнаруженными Соколовым с соавт. [17] и Ерниссе [18], и их релаксацией в процессе окисления [16,19]. Тиллером в работе [20] была предложена двухслойная модель пленки оксида с блокирующим пограничным слоем, имеющим транспортные свойства, отличные от остального объема оксида. Критика выше перечисленных моделей приведена в монографиях [6,7].

Во всех выше упомянутых моделях окисления кремния полагалось, что реакция окисления происходит на плоской межфазной границе диоксида с кремнием SiO<sub>2</sub>—Si. Исследования с помощью различных физических методик показали, что граница термического диоксида кремния с кремнием SiO<sub>2</sub>—Si не является резкой, а имеется переходной слой с нарушенной стехиометрией SiO<sub>y</sub>, y < 2, шириной 5–10 Å [21–23].

Переходный слой образуется естественным образом при объемной реакции двух первоначально пространственно разделенных реагентов A и B:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \to \mathbf{C} \tag{2}$$

(см., например, [24]). При достаточно больших значениях константы скорости реакции взаимодействие реагентов происходит на фронте реакции — в реакционной зоне, расположенной между этими реагентами. Модели окисления кремния с объемной реакцией типа (2) были предложены Гадияком [25] и Алмейда с соавт. [26]. Окисление описывалось решением диффузионно-реакционных уравнений для окислителя (атомарного [25] или молекулярного [26] кислорода), кремния и продукта их реакции — диоксида кремния. Параметрами моделей [25,26] являлись коэффициент диффузии кислорода в оксиде и константа скорости реакции окисления. В рамках обеих моделей был удовлетворительно описан начальный этап термического окисления кремния без привлечения каких-либо дополнительных механизмов его ускорения. Модель [26] использовалась Кжемински с соавт. [27] для описания кинетики роста нанометровых пленок диоксида кремния. Отметим, однако, что найденные в работах [25-27] коэффициенты диффузии кислорода не соответствовали ни значению, определенному из константы параболического окисления  $k_p$  [3], ни экспериментальным значениям коэффициента диффузии кислорода в плавленом кварце [28,29] — как по величине, так и по энергии активации (*E* = 2.03-2.46 эВ в работах [25-27] и *E* = 0.93-1.23 эВ в работах [3,28,29]). В модели [25] температурные зависимости найденных коэффициентов диффузии оказались разными для разных экспериментов, а в модели [26] значения найденных констант скорости реакции вообще не укладывались на одну температурную зависимость (см. табл. 1 в работе [26]). Отметим также, что во всех трех упомянутых работах [25-27] расчетные кинетики соответствовали экспериментальным данным только на самом начальном этапе окисления — при толщинах оксида до 20–30 нм, тогда как при больших значениях толщин наблюдалось расхождение, увеличивающееся по мере увеличения толщины оксида.

Цель данной работы состояла в разработке модели термического окисления кремния в сухом кислороде на основе объемной реакции типа (2) в широком диапазоне толщин диоксида кремния, включая начальный этап.

# 2. Описание модели

В отличие от модели Дила–Гроува [2,3] и других линейно-параболических моделей [8–15] полагаем, что реакция окисления кремния идет не на плоской границе раздела SiO<sub>2</sub>–Si, а может происходить по всему объему рассматриваемой системы SiO<sub>2</sub>–Si между поверхностью SiO<sub>2</sub> (x = 0) и некой плоскостью в глубине подложки Si (x = h), куда могут дойти молекулы окислителя,

$$\operatorname{Si} + \operatorname{O}_2 \xrightarrow{k} \operatorname{SiO}_2, \quad 0 \le x \le h,$$
 (3)

где *k* — константа скорости объемной реакции окисления. Диффузия кислорода в рассматриваемой системе SiO<sub>2</sub>-Si с учетом реакции его взаимодействия с кремнием (3) описывается следующей системой диффузионнореакционных уравнений:

$$\frac{\partial C_{\rm A}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left( D_{\rm A} \frac{\partial C_{\rm A}}{\partial x} \right) - k C_{\rm A} C_{\rm B},\tag{4}$$

$$\frac{\partial C_{\rm B}}{\partial t} = -kC_{\rm A}C_{\rm B},\tag{5}$$

$$\frac{\partial C_{\rm C}}{\partial t} = k C_{\rm A} C_{\rm B},\tag{6}$$

где x — координата, отсчитываемая от поверхности диоксида, t — время окисления,  $C_A$ ,  $C_B$  и  $C_C$  — концентрации окислителя, кремния и диоксида кремния соответственно,  $D_A$  — коэффициент диффузии кислорода. Коэффициенты диффузии кремния и продукта реакции диоксида кремния в уравнениях (5), (6) полагались нулевыми. Кислород диффундирует в диоксиде кремния и в кремнии со своими парциальными коэффициентами диффузии. Полагаем, что в области изменения состава (реакционной зоне) коэффициент диффузии кислорода линейно зависит от состава:

$$D_{\rm A} = \frac{D_{\rm AC}C_{\rm C} + D_{\rm AB}C_{\rm B}}{C_{\rm C} + C_{\rm B}},\tag{7}$$

где  $D_{AB}$  — коэффициент диффузии кислорода в кремнии ( $D_{AB} = 0.13 \exp(-2.53/k_BT) \operatorname{cm}^2/c$  [30]),  $D_{AC}$  — коэффициент диффузии кислорода в диоксиде кремния. Как и в [16,19], полагаем, что коэффициент диффузии кислорода в диоксиде кремния замедляется внутренними механическими напряжениями сжатия. Последние максимальны вблизи границы раздела SiO<sub>2</sub>-Si (в нашем случае — на границе реакционной зоны), а при удалении

от нее падают вследствие вязкоупругой релаксации [31]. В рамках линейной вязкоупругой теории Максвелла релаксация напряжений и соответствующая пластическая деформация происходят по экспоненциальному закону от времени [32]. Полагаем, что по аналогичному закону изменяется и коэффициент диффузии кислорода в каждом элементе диоксида кремния:

$$D_{\rm AC} = D_0 + (D_1 - D_0) \exp\left[-\frac{t(x)}{\tau}\right],$$
 (8)

где  $D_0$  — коэффициент диффузии кислорода в ненапряженном диоксиде кремния вдали от границы с кремниевой подложкой,  $D_1$  — коэффициент диффузии кислорода в напряженном диоксиде кремния на границе реакционной зоны, t(x) — время существования элемента диоксида кремния dx с координатой  $x \div (x + dx)$ ,  $\tau$  — характеристическое время релаксации коэффициента диффузии. Коэффициент диффузии кислорода в ненапряженном диоксиде кремния  $D_0$  полагаем равным коэффициенту диффузии кислорода в плавленом кварце:  $D_0 = 4.5 \cdot 10^{-5} \exp(-0.93/k_{\rm B}T) \, {\rm cm}^2/{\rm c}$  [29]. Константа скорости объемной реакции окисления в диффузионном приближении, характерном для взаимодействия точечных дефектов в твердых телах [33], определяется выражением

$$k = 4\pi R D_{\rm A},\tag{9}$$

где *R* — радиус взаимодействия молекул окислителя с атомами кремния. При достаточно большой константе скорости реакции k или радиусе взаимодейстия R реакция (3) происходит не по всему рассматриваемому объему  $(0 \le x \le h)$ , а сосредотачивается на фронте реакции — в реакционной зоне между растущей пленкой диоксида кремния и кремниевой подложкой. В образующейся реакционной зоне происходит изменение концентрации кремния от 0 до 100%, а концентрации продукта реакции соответственно от 100 до 0%. Эта реакционная зона является аналогом переходного слоя между диоксидом кремния и кремнием, наблюдаемого экспериментально с помощью различных физических методик [21-23], в котором происходит изменение стехиометрии SiO<sub>v</sub> от y = 0 на границе с кремниевой подложкой до у = 2 на границе со стехиометрическим диоксидом кремния. Начальное распределение оксида задаем в виде гауссиана:

$$C_{\rm C}(x,0) = C_{\rm C0} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right),\qquad(10)$$

где  $C_{\rm C0}$  — собственная концентрация формульных единиц диоксида кремния ( $C_{\rm C0} = 2.2 \cdot 10^{22} \, {\rm cm}^{-3}$ ),  $\sigma$  дисперсия. Величина дисперсии задавалась такой, чтобы начальная толщина диоксида соответствовала толщине естественного оксида на поверхности кремния (10 Å при  $\sigma = 3.5$  Å). Соответственно для начального распределения кремния имеем

$$C_{\rm B}(x,0) = C_{\rm B0} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \right], \qquad (11)$$

где  $C_{\rm B0}$  — собственная концентрация атомов кремния  $(C_{\rm B0} = 5 \cdot 10^{22} \, {\rm cm}^{-3})$ . Начальную концентрацию кислорода считаем нулевой

$$C_{\rm A}(x,0) = 0. \tag{12}$$

Концентрация кислорода на поверхности диоксида кремния равна предельной растворимости кислорода в аморфном диоксиде кремния при давлении 1 атм [29]

$$C_{\rm A}(0,t) = 4.8 \cdot 10^{15} \exp(0.18/k_{\rm B}T) \,{\rm cm}^{-3}.$$
 (13)

Толщина диоксида кремния рассчитывалась по соотношению

$$x_{\mathrm{ox}}(t) = \int_{0}^{n} C_{\mathrm{C}}(x,t) dx / C_{\mathrm{C0}}.$$

Скорость окисления рассчитывалась как  $v_{ox} = dx_{ox}(t)/dt$ .

Решение системы (4)-(6) с начальными условиями (10)-(12) и граничным условием (13) проводилось численными методами по неявной и явной разностным схемам. Определяемыми параметрами модели являлись:  $D_1$ ,  $\tau$  и R. Результаты расчета сравнивались с экспериментальными кинетиками окисления кремния ориентации (100), полученными Массоудом с соавт. в работе [8] методом эллипсометрии пластин непосредственно в термической печи (*in situ*).

# 3. Результаты расчета

Как отмечалось выше, при достаточно больших значениях радиуса R взаимодействие между кислородом и кремнием происходит на фронте реакции — в реакционной зоне, которая является аналогом переходного слоя. Влияние радиуса взаимодействия на профили компонентов и ширину реакционной зоны показано на рис. 1. Как видно из рисунка, с увеличением радиуса взаимодействия крутизна профилей кремния, оксида и кислорода в реакционной зоне увеличивается, а сама ширина реакционной зоны уменьшается. В качестве ширины реакционной зоны бралась разница глубин, соответствующих концентрациям кремния и оксида на уровне 0.95 от соответствующих максимальных. Ширина реакционной зоны устанавливается на стационарном уровне за время образования диоксида такой же толщины и далее не изменяется. Практически не зависит она и от температуры окисления. Значение радиуса взаимодействия *R* подбиралось таким образом, чтобы ширина реакционной зоны соответствовала среднему значению ширины переходного слоя  $\delta \approx 7.5$  Å. По данным работ [21-23] интервал толщин этого слоя составлял (5-10 Å). При найденной далее величине  $D_1$  получено значение R = 0.15 Å.



**Рис. 1.** Концентрационные профили распределения кислорода (1, 1'), кремния (2, 2') и диоксида кремния (3, 3') при значениях R, Å: 1-3 - 0.15, 1'-3' - 0.015. Время окисления, мин: 1-3 - 215, 1'-3' - 370 при  $T = 800^{\circ}$ С.



Рис. 2. Влияние коэффициента диффузии кислорода в SiO<sub>2</sub>  $(D_{AC})$  на скорость окисления кремния  $(T = 1000^{\circ}C)$ .  $I - D_{AC} = D_1 = 9.2 \cdot 10^{-10} \text{ см}^2/\text{с}, 2 - D_{AC} = D_0 = 9.4 \cdot 10^{-9} \text{ см}^2/\text{с}, 3 - D_{AC}$ , полученное по выражению (8) при  $\tau = 3.2 \text{ ч}, 4$  — расчет по модели Дила-Гроува [2,3]. Точки — эксперимент [8].

Влияние коэффициента диффузии кислорода в диоксиде кремния на скорость окисления показано на рис. 2. Как видно из рисунка, при малом и постоянном значении коэффициента диффузии ( $D_{AC} = D_1$ ) (кривая 1) модель удовлетворительно описывает только самый начальный участок экспериментальной зависимости. При большом и постоянном значении коэффициента диффузии

Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 11

 $(D_{AC} = D_0)$  (кривая 2) зависимость идет выше экспериментальной. И только при переменном коэффициенте диффузии кислорода в диоксиде кремния в соответствии с выражением (8) расчетная зависимость (кривая 3) удовлетворительно описывает как начальный участок при малых толщинах диоксида, так и конечный участок при больших толщинах диоксида, где она совпадает с расчетом по модели Дила–Гроува [2,3] (кривая 4).

Зависимости коэффициента диффузии кислорода  $D_A$  от координаты в системе SiO<sub>2</sub>-Si в соответствии с выражениями (7) и (8) показаны на рис. 3. При температуре 1000°С (кривая 1) коэффициент диффузии падает от значения  $D_A = D_0$  в ненапряженном диоксиде кремния на поверхности диоксида кремния (1') до значения  $D_A = D_1$  в напряженном диоксиде кремния на границе реакционной зоны (2') и далее до значения коэффициента диффузии кислорода в кремниевой подложке  $D_A = D_{AB}$  (3').

При уменьшении температуры до 900 (кривая 2) и 800°С (кривая 3) скорость восстановления коэффициента диффузии кислорода в диоксиде кремния от  $D_1$  до  $D_0$ уменьшается из-за возрастания  $\tau$ , поэтому на поверхности диоксида коэффициент диффузии кислорода  $D_A$  не достигает значения  $D_0$ .

Сопоставление расчетных зависимостей скорости окисления от толщины диоксида кремния с экспери-



Рис. 3. Зависимости коэффициента диффузии кислорода в системе SiO<sub>2</sub>-Si  $(D_A)$  от координаты при температурах, °C:  $I - 1000 \ (\tau = 3.2 \,\text{ч}), \ 2 - 900 \ (\tau = 33.6 \,\text{ч}), \ 3 - 800 \ (\tau = 548 \,\text{ч})$  и временах окисления, мин:  $I - 500, \ 2 - 1700, \ 3 - 2500$ . Значками обозначены значения:  $I' - D_0, \ 2' - D_1, \ 3' - D_{AB}$ .



**Рис. 4.** Зависимости скорости термического окисления Si (100) от толщины диоксида кремния. Температура окисления, °C: *1* — 800, *2* — 850, *3* — 900, *4* — 950, *5* — 1000. Сплошные линии — расчет по рассматриваемой модели, штриховые — расчет по модели Дила–Гроува [2,3], точки — эксперимент [8].

ментальными данными для температур в диапазоне 800–1000°С из работы [8] показано на рис. 4. Как видно из рисунка, хорошее соответствие расчета по рассматриваемой модели (сплошные линии) с экспериментом в отличие от расчета по модели Дила–Гроува [2,3] (штриховые линии) получено во всем интервале толщин диоксида кремния, включая начальный участок, при следующих температурных зависимостях параметров модели (кривые *1* на рис. 5 и 6):

$$D_1 = 0.34 \exp\left(-\frac{2.17}{k_{\rm B}T}\right) \, {\rm cm}^2/{\rm c},$$
 (14)

$$au = 1.17 \cdot 10^{-8} \exp\left(\frac{3.03}{k_{\rm B}T}\right) \,{\rm c.}$$
 (15)

### 4. Обсуждение результатов

В рассматриваемой модели радиус взаимодействия окислителя с кремнием R = 0.15 Å находился по ширине реакционной зоны  $\delta \approx 7.5$  Å, которая соответствует среднему значению ширины переходного слоя из работ [21–23] (5–10 Å). Найденное значение радиуса взаимодействия составляет 6% от межатомного расстояния в кремнии (a = 2.35 Å) и 9% от длины связи Si-O в диоксиде кремния (b = 1.62 Å), что ниже типовых значений радиуса взаимодействия для точечных дефектов в твердых телах ( $R \approx a, b$ ). Таким образом, в предлагаемой модели внутренние механические напряжения в диоксиде кремния оказывают влияние на константу скорости химической реакции окисления не только опосредованно — через уменьшение коэффициента диффузии кислорода в реакционной зоне на границе с кремнием (см. выражения (7)-(9)), но и непосредственно —



**Рис. 5.** Температурные зависимости коэффициента диффузии кислорода в диоксиде кремния: 1 — рассматриваемая модель  $(D_1), 2$  — [29]  $(D_0), 3$  — [2,3], 4 — [26], 5-5'' — [25], 6 — [27].



**Рис. 6.** Температурные зависимости времени релаксации коэффициента диффузии: *1* — рассматриваемая модель; *2*, *2'* — [38], *3*–*3'''* — [39], *4* — [40].

Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 11

через радиус взаимодействия окислителя с кремнием. Этот результат объясняется необходимостью свободного объема для протекания твердотельной реакции (3).

Коэффициент диффузии кислорода в ненапряженном диоксиде кремния D<sub>0</sub> в нашей модели соответствует коэффициенту диффузии в плавленом кварце из работы [29] (рис. 5, кривая 2, энергия активации E = 0.93 эВ), а также близок к коэффициенту диффузии кислорода, определенному из константы параболического окисления в модели Дила-Гроува [2,3] (рис. 5, кривая 3, E = 1.23 эВ). Найденный в рассматриваемой модели коэффициент диффузии кислорода в напряженном диоксиде кремния на границе реакционной зоны D<sub>1</sub> (14) (рис. 5, кривая *1*, *E* = 2.17 эВ) на 1–1.5 порядка меньше D<sub>0</sub> и близок к коэффициенту диффузии, найденному в работе Алмейда и др. [26] (кривая 4,  $E = 2.03 \, \text{эB}$ ), но значительно выше соответствующих коэффициентов диффузии, найденных в работах Гадияка [25] (кривые 5-5'', E = 2.25-2.46 эВ) и Кжемински [27] (кривые 6, E = 2.22 эВ) при близких энергиях активации. Разброс значений коэффициентов диффузии кислорода в напряженном диоксиде кремния в объемных моделях [25-27], описывающих только начальный этап окисления, связан, на наш взгляд, с тем обстоятельством, что константа скорости реакции в этих моделях не фиксировалась, как в нашей модели, а подбиралась вместе с коэффициентом диффузии. Не учитывалась в [25-27] также и релаксация коэффициента диффузии со временем окисления. Отметим, что увеличение энергии активации константы параболического окисления, связанной с коэффициентом диффузии кислорода, на начальном этапе окисления отмечалось и в линейнопараболических моделях [10,34,35]. Увеличение энергии активации диффузии кислорода до 2.0-2.4 эВ в тонких слоях аморфного диоксида кремния повышенной плотности на кремнии наблюдается экспериментально [36], а также следует из расчетов по методу Монте-Карло [37].

Характеристическое время релаксации, найденное в рассматриваемой модели для коэффициента диффузии в диоксиде кремния (15) (рис. 6, кривая 1), примерно на порядок выше экспериментальных зависимостей времен релаксации внутренних напряжений в пленках диоксида кремния на кремнии, определенных рентгеновским методом в работах [38,39] (кривые 2, 2' и 3-3'''), но уступает временам релаксации, найденным из коэффициента преломления, определенного эллипсометрическим методом в работе [40] (точки 4 на рис. 5). Поскольку коэффициент преломления связан с плотностью диоксида кремния [40], можно сделать вывод, что релаксация коэффициента диффузии связана не только с релаксацией внутренних механических напряжений, как это полагалось в [16,19], но также и с релаксацией плотности диоксида кремния. Последняя происходит в результате процессов перестройки и полимеризации в структуре аморфного диоксида кремния при удалении от реакционной зоны и кремниевой подложки, оказывающей упорядочивающее влияние на прилегающий к ней новообразованный диоксид кремния [7,41].

Характеристическая длина изменения коэффициента диффузии кислорода в диоксиде кремния, соответствующая толщине диоксида, выросшего за время релаксации коэффициента диффузии  $\tau$ , изменяется от 450 нм при  $T = 800^{\circ}$ С до 110 нм при  $T = 1000^{\circ}$ С. Это значительно больше, чем ширина переходного слоя (5-10 Å), в котором только и полагалось изменение коэффициента диффузии ранее [20,42]. Такое широкодиапазонное изменение коэффициента диффузии коррелирует с результатами экспериментальных работ [43,44] по измерению проницаемости и внутренних напряжений в пленках диоксида кремния в зависимости от их толщины. В работе [43] показано, что проницаемость пленки диоксида кремния на кремнии для водорода увеличивается с толщиной пленки с градиентом, сохраняющимся до толщин диоксида 80-120 нм при температурах окисления кремния 1000-900°С. Градиент внутренних напряжений сохраняется до несколько меньших толщин 40-80 нм при температурах окисления кремния 1000-800°C [44], т. е. характеристическая длина изменения коэффициента диффузии кислорода сопоставима с толщинами пленок термического диоксида кремния на кремнии, в которых имеет место структурная неоднородность.

# 5. Заключение

Разработана модель термического окисления кремния, в которой взаимодействие окислителя с кремнием происходит на фронте объемной реакции — в реакционной зоне. Ширина реакционной зоны в этой модели  $(\delta \approx 7.5 \text{ \AA})$  соответствует средней ширине переходного слоя с нарушенной стехиометрией, наблюдаемого экспериментально [21-23], и определяется радиусом взаимодействия (R = 0.15 Å). Коэффициент диффузии кислорода в ненапряженном диоксиде кремния D<sub>0</sub> соответствует коэффициенту диффузии в плавленом кварце [28], а при приближении к реакционной зоне спадает по экспоненциальному закону со временем до значения  $D_1$ в напряженном диоксиде кремния. Энергия активации коэффициента диффузии кислорода в напряженном диоксиде кремния  $D_1$  (2.17 эВ) выше, чем в ненапряженном диоксиде кремния  $D_0$  (0.93 эВ), и соответствует экспериментальным [36] и теоретическим [37] данным по диффузии кислорода в уплотненном диоксиде кремния. Характеристическое время релаксации коэффициента диффузии сопоставимо с временами релаксации внутренних механических напряжений [38,39] и коэффициента преломления или плотности диоксида кремния [40]. Соответствующая характеристическая длина изменения коэффициента диффузии кислорода сопоставима с толщинами пленок термического диоксида кремния на кремнии, в которых имеет место широкодиапазонная структурная неоднородность — изменение проницаемости [43] и внутренних механических напряжений [44].

# Список литературы

- [1] R.L. Opila, D.W. Hess. J. Electrochem. Soc., 150, S1 (2003).
- [2] B.E. Deal, A.S. Grove. J. Appl. Phys., 36, 3770 (1965).
- [3] B.E. Deal. J. Electrochem. Soc., **125**, 576 (1978).
- [4] N.F. Mott, S. Rigo, F. Rochet, A.M. Stoneham. Phil. Mag. B, 60, 189 (1989).
- [5] I.J.R. Boumvol. Surf. Sci. Rep., 36, 1 (1999).
- [6] Н.А. Колобов. В кн.: Математическое моделирование процессов тепло и массопереноса (М., Наука, 1987) с. 280.
- [7] Г.Я. Красников, Н.А. Зайцев. Система кремний-диоксид кремния субмикронных СБИС (М., Техносфера, 2003).
- [8] H.Z. Massoud, J.D. Plummer, E.A. Irene. J. Electrochem. Soc., 132, 2685, 2693 (1985).
- [9] H.Z. Massoud, J.D. Plummer. J. Appl. Phys., 62, 3416 (1987).
- [10] C.-J. Han, C.R. Helms. J. Electrochem. Soc., 134, 1297 (1987).
- [11] H. Wong, Y.C. Cheng. J. Appl. Phys., 64, 893 (1988).
- [12] E.A. Irene. J. Appl. Phys., 54, 5416 (1983); A.G. Revesz,
   B.J. Mrstik, H.L. Hughes, D. McCarthy. J. Electrochem. Soc.,
   133, 587 (1986).
- [13] S.A. Schafer, S.A. Lion. Appl. Phys. Lett., 47, 154 (1985).
- [14] R.B. Beck, B. Majkusiak. Phys. Status Solidi A, 116, 313 (1989).
- [15] В.А. Арсламбеков, А. Сафаров. Микроэлектроника, 6, 75 (1977).
- [16] A. Fargeix, G. Ghibaudo, G. Kamarinos. J. Appl. Phys., 54, 2878 (1983).
- [17] В.И. Соколов, Н.А. Федорович, В.А. Шеленшкевич. ФТТ, 18, 1794 (1976).
- [18] E.P. Eernisse. Appl. Phys. Lett., 38, 8 (1979).
- [19] A. Fargeix, G. Ghibaudo. J. Appl. Phys., 56, 589 (1984).
- [20] W.A. Tiller. J. Electrochem. Soc., 130, 501 (1983).
- [21] K.T. Queeney, M.K. Weldon, J.P. Chang, Y.J. Chabal, A.B. Gurevich, J. Sapjeta, R.L. Opila. J. Appl. Phys., 87, 1322 (2000).
- [22] K. Kimura, K. Nakajima. Appl. Surf. Sci., 216, 283 (2003).
- [23] A.R. Chowdhuri, D.-U. Jim, C.G. Takoudis. Thin Sol. Films, 457, 402 (2004).
- [24] H. Larralde, M. Araujo, S. Havlin, H.E. Stanley. Phys. Rev. A, 46, 855 (1992).
- [25] Г.В. Гадияк. Микроэлектроника, 27, 288 (1998).
- [26] R.M.C. de Almeida, S. Goncalves, I.J.R. Baumvol, F.C. Stedile. Phys. Rev. B, 61, 12 992 (2000).
- [27] C. Krzeminski, G. Larrieu, J. Penaud, E. Lampin, E. Dubois. J. Appl. Phys., **101**, 064 908 (2007).
- [28] F.J. Norton. Nature, **191**, 701 (1961).
- [29] K. Kajihara, M. Hirano, M. Uramoto, Y. Morimoto, L. Skuja, H. Hosono. J. Appl. Phys., 98, 013 527 (2005).
- [30] M. Stavola, J.R. Patel, L.C. Kimerling, P.E. Freeland. Appl. Phys. Lett., 42, 73 (1983).
- [31] E. Kobeda, E.A. Irene. J. Vac. Sci. Technol. B, 6, 574 (1988).
- [32] E.A. Irene, E. Tierney, J. Angilello. J. Electrochem. Soc., 129, 2594 (1982).
- [33] T.R. Waite. Phys. Rev., 107, 463 (1957).

- [34] E.A. Irene, Y.J. van der Meulen. J. Electrochem. Soc., 123, 1380 (1976).
- [35] S. Kamohara, Y. Kamigaki. J. Appl. Phys., 69, 7871 (1991).
- [36] M.L. Green, E.P. Gusev, R. Degraeve, E.L. Garfunkel. J. Appl. Phys., 90, 2057 (2001).
- [37] A. Bongiorno, A. Pasquarello. Phys. Rev. B, 70, 195312 (2004).
- [38] W. Hartman, G. Franz. Appl. Phys. Lett., 37, 1004 (1981).
- [39] Y. Nishino, T. Imura. Phys. Status Solidi A, 74, 193 (1982).
- [40] L.M. Landsberger, W.A. Tiller. Appl. Phys. Lett., 51, 1416 (1987).
- [41] Г.Я. Красников, Н.А. Зайцев, И.В. Матюшкин. ФТП, 37, 44 (2003).
- [42] T. Watanabe, K. Tatsumura, I. Ohdomari. Phys. Rev. Lett., 96, 196 102 (2006).
- [43] K. Taniguchi, M. Tanaka, C. Hamaguchi. J. Appl. Phys., 67, 2195 (1990).
- [44] B.J. Mrstik, P.J. McMarr. Phys. Rev. B, 48, 17972 (1993).

Редактор Т.А. Полянская

# Model of thermal silicon oxidation at the front of volumetric reaction

O.V. Aleksandrov, A.I. Dusj

The St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI",

197376 St. Petersburg, Russia

**Abstract** The model of thermal silicon oxidation has been developed, in which the interaction with an oxidizer occurs at the front of volumetric reaction. Width of a reaction zone corresponds to width of a transition layer with broken stoichiometric ( $\delta \approx 7.5$  Å). Relaxation of oxidizer diffusion coefficient from meaning in stressed silicon dioxide up to meaning in unstressed silicon dioxide which equal to diffusion coefficient in a fused quartz was taken into account. Relaxation is related with structural reorganization of amorphous silicon dioxide at move away from a reaction zone boundary. The model describes well the thermal silicon oxidation kinetic in dry oxygen in a wide range of silicon dioxide thickness, including an initial stage.